

自動化工業

中國砂輪晶圓級可回焊鑄造鏡片技術 有助手機降低生產成本

2010/10/10

【台北訊】中國砂輪新推出晶圓級可回焊鑄造鏡片技術，可縮短相機模組在相關實裝工程耗費的時間，也降低套管及FPC成本，降低相機模組的體積。

中國砂輪（KINIK）副董事長白文亮表示，未來雙鏡頭照像手機將越趨便宜且需求亦穩定擴大，由於傳統相機模組組裝成本高，且佔用較大的空間，一般塑膠鏡片無法通過可回焊製程，若使用模造玻璃鏡片則價格昂貴，如何降低相機模組的整體製造成本與體積已成為重要關鍵。

白文亮指出，晶圓級可回焊鑄造鏡片技術與傳統製程不同，並具有傳統製程沒有辦法做到的優勢。如手機組裝製程簡化、製程時間縮短、降低製作成本約30%、可耐高溫至260度的可回流焊接、比現行鏡頭減少50%的體積；此技術可應用在手機、遊戲機及監視器等領域。

目前市面上所製作的Wafer Level Lens多為混合式的樹脂+玻璃基板，製作結構複雜，使光學設計及製作困難，且厚度過厚。而中國砂輪採用的Casting製作結構簡單，光學設計與製作因而變的相對容易，且厚度較薄。成為中國砂輪在製程上的優勢特色。

隨著材料的技術的進步，未來高階相機鏡頭的發展將越趨穩定，並期望能在未來應用於LD、硬碟讀取頭、其他成像消費電子產品等，應用於更多不同的領域範圍。

多孔質透氣陶瓷板已在半導體晶圓的研磨及切割製程中扮演重要的角色，在TFT-LCD及太陽能各製程及檢測中，面板的運送及固定、多孔質透氣陶瓷板、提供機台設計上更多樣的選擇。（金萊萊）



中國砂輪副董事長白文亮對新產品信心十足。金萊萊 / 攝影

 TOP